



## Alchimer 筹资 1000 万美元用于加强全球用户支持及推进新知识产权开发

这笔资金能够帮助提供商更好地满足市场对硅通孔互连三维封装所需的湿式沉积制程不断增长的需求

美国商业资讯法国 Massy 消息——

Alchimer S.A. 是质优价廉的湿式沉积制程的领先提供商，其产品用于先进的三维封装应用中的互连。公司今日宣布新近获得 1000 万美元的融资资金，将用于加强用户支持项目，以及推进新知识产权（IP）的开发。

Alchimer 的第 4 轮融资来源既包括一些原有的投资人，也有一些新的投资人，如 AGF 保险公司、法国原子能总署投资公司（CEA Investissement）和 Emertec Gestion 等。

法国格勒诺布尔 Emertec Gestion 的普通合伙人 Jean-Philippe Stefanini 说：“我们期待 Alchimer 为三维封装技术做出重大贡献，并对下一代设备产生重要的影响。Alchimer 与我们的运营模式十分契合，而且我们对其经验丰富的管理团队抱有充分的信心。”

Alchimer 的 CEO Steve Lerner 说：“投资人的不懈支持，尤其是在当前困难的经济形势下，是 Alchimer 坚持技术创新的坚实基础，同时也表明 Alchimer 的电接枝（electrografting）技术以其强化制程和降低成本的特点，对三维市场的发展起到了积极的推动作用。”

Alchimer 最近宣布通过硅通孔（TSVs）增强铜晶种金属化的 eG ViaCoat 制程，硅通孔的作用是实现先进的三维封装应用中的互连。这种结构通常比较狭长，较高的宽高比给薄膜的均匀沉积带来许多难题。eG ViaCoat 制程使用化学品在薄膜上形成沉积，其均匀度能够达到甚至超过标准的行业质量指标。除了具有若干制程上的优势之外，这种“湿式”法还允许在旧式电镀设备上实施 eG ViaCoat，从而避免了翻新或改装的麻烦。

此外，Alchimer 还宣布已与日本的技术营销公司 Nagase & Co. Ltd. 签署了一项协议。Nagase 具有深厚的化学品、塑料和电子产品背景，根据协议，它将帮助 Alchimer 满足主要的日本用户不断扩大的需求。这进一步说明，作为 TSV 铜晶种和相关薄膜的一种低价替代品，公司的产品正逐步被市场接受。

Lerner 说：“Nagase 将使我们在化学品和电子产品市场享受到合作的优势，并将为我们的日本用户提供优质的支持服务。”

公司同时宣布，已聘请经验丰富的行业老手 Kathy Cook 担任北美地区的业务发展总监。Cook 在半导体行业的制造、销售和业务发展领域拥有超过 15 年的任职经历，他曾经供职的公司有 Applied Materials、Millipore Corp.、ULVAC Technologies 和 SUSS MicroTec 等。

### 关于 Alchimer S.A

Alchimer 从事创新的化学配方、制程和 IP 的开发和营销，其产品主要用于纳米薄膜的沉积，可提供半导体互连和三维 TSVs（硅通孔）。公司的突破性电接枝（eG™）技术是一种基于电化学的制程，能够在导体和半导体表面生成各种类型的超薄镀层，Alchimer 总部位于法国的 Massy，是法国原子能总署（Commissariat à l’Energie Atomique, CEA）的分拆资产。公司于 2001 年正式成立，并于当年获得法国研发及产业局（French Minister of Research and Industry）颁发的“高新科技公司创立国家首奖”（First National Award for the

Creation of High Tech Companies)。公司现为“《红鲱鱼》欧洲 100 强公司”（Red Herring Top 100 European Company）之一。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

**联系方式：**

SangSok (s.s.) Lee  
Lenix Technology Inc.  
韩国  
电话：+82-31-919-5561  
[sslee@lenix.co.kr](mailto:sslee@lenix.co.kr)

或

Kathy Cook  
Alchimer  
业务发展总监  
电话：+1 214 649 6153  
[kathy.cook@alchimer.com](mailto:kathy.cook@alchimer.com)

或

Sarah-Lyle Dampoux  
Loomis Group  
电话：+33 1 58 18 59 30  
[dampoux@loomisgroup.com](mailto:dampoux@loomisgroup.com)